

耐高温芯片密封胶 904A/H-426

一、简介:

耐高温芯片密封胶 904A/H-426 是一种双组份热固化的灌封材料,它在固化后成为致密性固体结构,具有很高的硬度,耐热性能好比通常的加温型产品具有更高的耐温等级,耐温达到 150 度,极难拆卸,可起到保护、防水、保密的作用。

二、常规性能:

测试项目	测试方法或条件	904A	H-426
外观	目测	黑色粘稠液体	无色透明液体
密度	25℃ g/cm ³	1.5-1.6	1.01-1.05
粘度	25℃ mpa·s	3000-5000	9-13
保存期限	室温通风	半年	半年

三、使用工艺:

项目	单位或条件	904A/H-426
混合比例	重量比	100: 15
可使用时间	25℃, 35g, hrs	2
固化条件	℃/hrs	80/4 或 150/1

四、用途: 适用于传感器,混合模块电路,小型电子元件等保密。

五、固化后特性:

项目	单位或条件	904A/H-426
硬度	Shore-D	80
热变形温度	℃	150
体积电阻率	25℃, Ω·cm	1.0×10 ¹⁴
绝缘强度	25℃, kV/mm	15
冲击强度	Kg/cm ²	7
介电常数	25℃, 1MHZ	4.0±0.05
介质损耗角正切	25℃, 1MHZ	0.02

六、贮存、运输及注意事项:

1. 此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号,然后对号入座;准确称量后,请充分搅拌均匀。
3. 被封装器件经 100℃/1-1.5hrs 干燥,去除水份,冷却至 30-40℃。
4. 封装时注意浸渍速度不宜过快,以确保浸渍均匀。

七、包装规格: 包装为 A:10KG, B: 5KG。

备注：以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。